

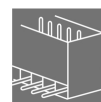
S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.3 mm, étamé, noir, Boîte
Référence	1295570000
Type	S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118092172
Qté.	96 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A

Emballage

Boîte

Date de création 4 novembre 2022 13:03:06 CET

S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	14,2 mm	Profondeur (pouces)	0,559 inch
Hauteur	14,2 mm	Hauteur (pouces)	0,559 inch
Hauteur version la plus basse	10,8 mm	Largeur	18,9 mm
Largeur (pouces)	0,744 inch	Poids net	3,14 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série B2L/S2L 3.50 - 2 rangées	Type de raccordement	Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/THR	Pas en mm (P)	3,5 mm
Pas en pouces (P)	0,138 inch	Angle de sortie	90°
Nombre de pôles	10	Nombre de picots par pôle	1
Longueur du picot à souder (l)	2,3 mm	Dimensions du picot à souder	d = 1,0 mm, octogonal
Diamètre du trou d'implantation (D)	1,3 mm	Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	+ 0,1 mm
Diamètre extérieur du plot de soudure	2,1 mm	Diamètre du trou de l'écran	1,9 mm
L1 en mm	14 mm	L1 en pouce	0,551 inch
Nombre de rangs	1	Nombre de pôles	2
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection appui de la main	Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 10
Codable	Oui	Force d'enfichage/pôle, max.	3 N
Force d'extraction/pôle, max.	6 N		

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIb
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Structure en couches du raccordement soudé	2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn brillant
Structure en couches du contact mâle	2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-30 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Données nominales selon CEI**

testé selon la norme

IEC 60664-1, IEC 61984

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 20 °C)

10 A

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 40 °C)

8,5 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

125 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

1,5 kV

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

2,5 kV

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 20 °C)

10 A

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 40 °C)

9 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

160 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

50 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

1,5 kV

Tenue aux courants de faible durée

3 x 1 s mit 77 A

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation

B / CSA)

150 V

Tension nominale (groupe d'utilisation

D / CSA)

150 V

Courant nominal (groupe d'utilisation C /

CSA)

9,5 A

Tension nominale (groupe d'utilisation

C / CSA)

50 V

Courant nominal (groupe d'utilisation B /

CSA)

5 A

Courant nominal (groupe d'utilisation

D / CSA)

9,5 A

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E60693

Tension nominale (groupe d'utilisation

B / UL 1059)

150 V

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Courant nominal (groupe d'utilisation B /

UL 1059)

10 A

Emballage

Emballage

Boîte

Longueur VPE

30 mm

Largeur VPE

135 mm

Hauteur VPE

350 mm

Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

UL File Number Search

Site Web UL

Certificat N° (UR)

E60693

Date de création 4 novembre 2022 13:03:06 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

3

S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL DRIVES EN FL DRIVES DE
Livre blanc technologie de montage en surface	Download Whitepaper

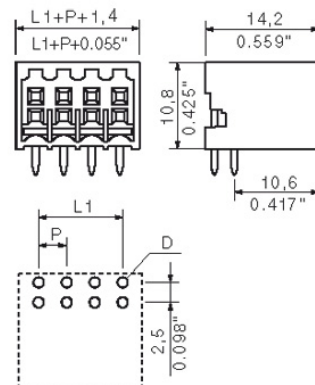
S2L-SMT 3.50/10/90G 2.3SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.